

证券代码：688512

证券简称：慧智微

公告编号：2024-018

## 广州慧智微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：尚睿微电子（上海）有限公司（以下简称“上海尚睿”），系广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“慧智微”）的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司预计为全资子公司提供担保额度不超过500万美元（折合人民币3,634.30万元）。截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为人民币0元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 本次担保无需经股东大会审议。

### 一、担保情况概述

公司于2024年7月4日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。全资子公司上海尚睿芯片研发完成后，需要委托供应商 Global Foundries Inc.（以下简称“Global Foundries”）进行晶圆代工厂流片生产。为了支持上海尚睿的业务发展，提升公司整体效益，董事会同意公司为上海尚睿在担保协议履约期间的付款义务提供不超过500万美元（折合人民币3,634.30万元）的连带责任保证。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，该议案无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

- 1.中文名称：尚睿微电子（上海）有限公司
- 2.成立时间：2012年2月28日
- 3.注册资本：人民币17,000万元
- 4.注册地：中国（上海）自由贸易试验区碧波路899号3幢8层、9层
- 5.统一社会信用代码：913101155904038455
- 6.法定代表人：李阳
- 7.股权结构：慧智微持股100%
- 8.主营业务：射频前端芯片及模组的研发、设计和销售
- 9.被担保人不是失信被执行人
- 10.不存在影响被担保人偿债能力的重大事项
- 11.与公司的关联关系：公司全资子公司
- 12.最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

财务情况	2023年12月31日/2023年度（经审计）	2024年3月31日/2024年第一季度（未经审计）
资产总额	7,237.65	11,299.70
净资产	-6,913.18	-9,050.39
营业收入	0.00	0.00
净利润	-10,572.10	-2,725.53
负债总额	14,150.83	20,350.09
扣除非经常性损益后的净利润	-10,578.99	-2,736.52

注：上述2023年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 三、签订的担保协议主要内容

上海尚睿委托供应商Global Foundries进行晶圆代工厂流片生产，公司同意为上海尚睿在未来一年内（2024年7月4日至2025年7月4日）的付款义务提供不超过500万美元（折合人民币3,634.30万元）的连带责任保证；公司与上海尚睿签订相关文件约定其在协议履约期间向Global Foundries采购的形成的应付采购款最高余额不超过500万美元

（折合人民币3,634.30万元），公司对上海尚睿有绝对的控制权，应付采购款余额规模不会超过约定的内容；

保证期间：1年；

截至本公告披露之日，公司已向Global Foundries出具担保函，具体内容以实际签署的担保函内容为准。

#### **四、担保的原因及必要性**

上述担保系根据子公司实际业务需要，为满足子公司项目发展需求而进行的，有利于保证子公司项目正常建设和业务顺利开展。上述担保的被担保方为公司全资子公司，财务状况稳健，信用情况良好，具备偿债能力和抗风险能力。

同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

#### **五、董事会意见**

董事会认为：上述担保事项是为满足子公司日常生产经营的需要，有利于促进公司业务开展。被担保人生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

#### **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告披露之日，公司及子公司的对外担保总额为500万美元（折合人民币3,634.30万元），占上市公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为1.67%和1.52%，公司对控股子公司提供的对外担保总额为500万美元（折合人民币3,634.30万元），占上市公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为1.67%和1.52%。公司及控股子公司均未发生对外担保逾期和涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

董事会

2024年7月6日